## 巻 頭 言

## " システムLSI "特集に寄せて

取締役 半導体事業本部長 理学博士

長澤紘一



1998年は,アジアからロシア・中南米まで経済危機のあらし(嵐)が吹き荒れ,元凶である日本も依然景気低迷に沈む苦しい年であった。半導体分野も 97年から続くメモリの世界的供給能力過剰が価格下落を呼び,それが全分野に波及した。事業存続をかけてDRAM製造からの撤退,工場閉鎖,部門の売却などの処置が各社で採られたことは記憶に新しい。

当社においても例外ではなく、半導体事業の低迷が全社の業績に影響を与える結果を招いた。しかし、今後当社が情報処理や情報通信事業へ新たな展開を得ていくためにはキーデバイスを受け持つ次の半導体事業の貢献が不可欠であることから、これまでの事態を厳しく受け止め、昨年1年をかけて事業を根底から変える対策を打ってきた。

それらは①システムLSI事業の強化,②コスト意識の徹底,③デザインオリエンテッド企業への転進である。①のシステムLSI事業は先端システムLSIと基幹デバイス群(マイコン/ASIC,パワーなど個別半導体素子)からなるが,当社の顔である先端システムLSIでは"eRAM"をコアコンピタンス(強み)とし,他社と明確に差別化できる技術をベースに事業を展開していく。このために0.18μmルール化を加速し,生産能力も増強する。開発費はeRAMに加え,同じ技術でコスト競争力のある高性能DRAMも生産し,回収を図る。その後は速やかに基幹デバイス群に技術を展開していく。②のコスト意識は従来からの運動を更に徹底したもの,③はエンジニアを大幅にシステムLSI設計にシフトさせ,社内構造から変革を図っているところである。システムLSIはシステム知識をチップ化するものである。システムLSIはシステム知識をチップ化するものである。

システムLSIを必要とする応用分野は幅広く,すべてを扱うことはリソース分散となるため,当社の扱うシステム応用分野を取捨選択した上で当社のIP開発と整備も集中する方針である。

これらに加えて,次世代0.15μm以降の技術開発と来るべきディジタル情報家電時代への布石として松下電器/松下電子工業株との開発協業を3社合意の下にスタートさせた。相互技術の補完によって市場競争力を持つ技術を迅速に確立すること,また,IP開発・保有に関しても協力していく考えである。他の社外協業とも併せて開発費の削減と効率化も追求する。

最も大事なことは、これらを成し遂げるスピードとコストだと思っている。顧客の要望・要求に間に合って始めて次の展開がある。そして利益の上がる体質(費用構造)を作り上げなければならない。

- ●間に合ってなんぼ(Time to Market)
- ●もう(儲)かってなんぼ(Cost Competitive Manufacturing)

の精神で着実に成果を上げていきたい。

今回の三菱電機技報半導体特集号 システムLSI特集 "では,先端システムLSI,基幹デバイス製品,銅配線に代表される重要プロセス技術など,当社が自信を持って取り組むシステムLSI製品とその技術の論文を集めており,お客様の御要求を満たす技術,お客様の役に立つチップの情報をお届けするものです。御一読,御参照いただければ幸いです。